

2025-2031年中国存储芯片 市场深度分析与投资战略报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2025-2031年中国存储芯片市场深度分析与投资战略报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202503/479569.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2025-2031年中国存储芯片市场深度分析与投资战略报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局市场服务行业的重要决策参考依据。

报告目录：

第1章：中国存储芯片行业发展概况

1.1 存储芯片行业发展概述

1.1.1 存储芯片相关定义及分类

（1）存储芯片相关定义

（2）存储芯片主要分类

1.1.2 存储芯片行业发展模式概述

1.2 中国存储芯片行业发展环境分析

1.2.1 行业发展经济环境分析

（1）宏观经济现状分析

（2）经济环境对行业发展影响

1.2.2 行业发展政策环境分析

（1）行业发展主要影响政策汇总

（2）行业发展重点政策解读

（3）政策环境对行业发展影响

1.2.3 行业发展社会环境分析

（1）居民收入与消费情况

（2）移动互联网快速发展

（3）智能产品的普及

（4）社会环境对行业发展影响

1.2.4 行业发展技术环境分析

（1）芯片制程技术发展路线图

（2）存储芯片工艺技术发展概述

1.3 存储芯片行业产业链分析

1.3.1 存储芯片产业链全景图

1.3.2 存储芯片产业链布局汇总

第2章：全球存储芯片行业现状及趋势分析

2.1 全球半导体产业行业与存储芯片

2.1.1 全球半导体行业发展现状

(1) 全球半导体行业转移路径分析

(2) 全球半导体行业市场规模

2.1.2 全球半导体行业结构分析

2.2 全球存储芯片行业发展概述

2.2.1 全球存储芯片行业发展概况

2.2.2 全球存储芯片行业发展历程

2.2.3 全球存储芯片行业发展特征

(1) 产业发展具有一定的周期性

(2) 行业集中度高，呈寡头垄断

(3) 资金投入大

2.3 全球存储芯片发展现状分析

2.3.1 全球存储芯片行业市场规模

2.3.2 全球存储芯片细分市场分析

(1) 全球存储芯片产品结构

(2) 全球DRAM市场规模分析

(3) 全球NAND FLASH市场规模分析

2.3.3 全球存储芯片行业区域分布

2.4 全球存储芯片竞争格局分析

2.4.1 全球存储芯片行业竞争层次

2.4.2 全球存储芯片企业布局对比

2.4.3 全球存储芯片企业市场份额

2.5 全球存储芯片最新技术进展

2.5.1 3D堆叠vs工艺微缩

(1) NAND Flash

(2) DRAM

2.5.2 新一代存储芯片开始量产

2.6 全球存储芯片市场前景预测

2.6.1 全球存储芯片市场前景预测

2.6.2 全球存储芯片主要细分产品市场前景预测

(1) 全球DRAM市场前景预测

(2) 全球NAND FLASH市场前景预测

第3章：中国存储芯片行业发展现状分析

3.1 中国存储芯片行业发展概述

3.1.1 中国存储芯片行业发展概况

3.1.2 中国存储芯片行业发展历程

3.2 中国存储芯片发展现状分析

3.2.1 中国半导体产业发展现状

(1) 中国半导体行业市场规模

(2) 中国半导体行业进出口现状

(3) 中国半导体行业市场结构

3.2.2 中国存储芯片市场规模分析

3.2.3 中国存储芯片产品结构分析

3.3 中国存储芯片最新技术进展

3.4 中国存储芯片行业发展存在问题分析

3.4.1 技术基础薄弱

3.4.2 市场集中度高，国内企业竞争力弱

第4章：中国存储芯片行业竞争现状分析

4.1 中国存储芯片行业五力竞争分析

4.1.1 中国存储芯片行业现有竞争者分析

4.1.2 中国存储芯片行业供应商议价能力分析

4.1.3 中国存储芯片行业替代品威胁分析

4.1.4 中国存储芯片行业潜在进入者威胁分析

4.1.5 中国存储芯片行业购买者议价能力分析

4.1.6 中国存储芯片行业竞争情况总结

4.2 中国存储芯片行业竞争格局分析

4.2.1 中国存储芯片行业竞争现状

4.2.2 中国存储芯片企业布局对比

4.2.3 中国存储芯片企业竞争格局

第5章：中国存储芯片主要产品发展分析

5.1 DRAM市场发展前景分析

5.1.1 DRAM产业发展概述

5.1.2 DRAM市场规模分析

5.1.3 DRAM市场竞争格局

5.1.4 DRAM厂商扩产情况

5.1.5 DRAM下游需求应用

5.1.6 DRAM技术发展情况

(1) DRAM制程进入1Z时代

(2) DDR系列性能持续优化

(3) DDR5获得突破

5.1.7 DRAM市场价格走势

5.1.8 DRAM市场前景预测

5.2 NAND FLASH市场发展与前景分析

5.2.1 NAND FLASH产业发展概述

5.2.2 NAND FLASH市场规模分析

5.2.3 NAND FLASH市场竞争格局

5.2.4 NAND FLASH厂商扩产情况

5.2.5 NAND FLASH下游需求应用

5.2.6 NAND FLASH技术发展情况

5.2.7 NAND FLASH市场价格走势

5.2.8 NAND FLASH市场前景预测

5.3 NOR FLASH市场发展与前景分析

5.3.1 NOR FLASH产业发展概述

5.3.2 NOR FLASH市场规模分析

5.3.3 NOR FLASH市场竞争格局

5.3.4 NOR FLASH厂商产能情况

5.3.5 NOR FLASH下游需求应用

5.3.6 NOR FLASH技术发展情况

(1) 中国各大厂商NOR FLASH技术发展情况

(2) NOR FLASH技术发展趋势

5.3.7 NOR FLASH市场价格走势

5.3.8 NOR FLASH市场前景预测

5.4 其他存储芯片市场分析

5.4.1 EEPROM

- (1) EEPROM市场应用现状
- (2) 应用领域
- (3) 竞争格局
- (4) 发展趋势

5.4.2 SRAM

5.4.3 PCM

- (1) PCM市场应用现状
- (2) PCM主要生产企业情况
- (3) PCM市场应用趋势

5.4.4 FeRAM

- (1) FeRAM市场应用现状
- (2) FeRAM主要生产企业情况
- (3) FeRAM市场应用趋势

5.4.5 MRAM

5.4.6 ReRAM

- (1) ReRAM市场应用现状
- (2) ReRAM主要生产企业情况
- (3) ReRAM市场应用趋势

第6章：全球及中国主要存储芯片企业分析

6.1 全球主要存储芯片企业分析

6.1.1 三星

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业业务结构分析
- (4) 企业销售网络分布
- (5) 企业存储芯片业务分析
- (6) 企业在华业务布局

6.1.2 SK海力士

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业业务结构分析

- (4) 企业销售网络分布
- (5) 企业存储芯片业务分析
- (6) 企业在华业务布局

6.1.3 美光

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业业务结构分析
- (4) 企业销售网络分布
- (5) 企业存储芯片业务分析
- (6) 企业在华业务布局

6.1.4 铠侠

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业业务结构分析
- (4) 企业销售网络分布
- (5) 企业存储芯片业务分析
- (6) 企业在华业务布局

6.1.5 西部数据

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业业务结构分析
- (4) 企业销售网络分布
- (5) 企业存储芯片业务分析
- (6) 企业在华业务布局

6.2 国内主要存储芯片企业分析

6.2.1 中芯国际集成电路制造有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业业务结构分析
- (4) 企业销售网络分布
- (5) 企业存储芯片业务分析
- (6) 企业发展优劣势分析

6.2.2 北京兆易创新科技股份有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业业务结构分析
- (4) 企业销售网络分布
- (5) 企业存储芯片业务分析
- (6) 企业发展优劣势分析

6.2.3 武汉新芯集成电路制造有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业业务结构分析
- (4) 企业存储芯片业务分析
- (5) 企业发展优劣势分析

6.2.4 紫光国芯微电子股份有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业业务结构分析
- (4) 企业销售网络分布
- (5) 企业存储芯片业务分析
- (6) 企业发展优劣势分析

6.2.5 普冉半导体（上海）股份有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业业务结构分析
- (4) 企业销售网络分布
- (5) 企业存储芯片业务分析
- (6) 企业发展优劣势分析

6.2.6 聚辰半导体股份有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业业务结构分析
- (4) 企业销售网络分布

(5) 企业存储芯片业务分析

(6) 企业发展优劣势分析

6.2.7 长江存储科技有限责任公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业业务结构分析

(4) 企业存储芯片业务分析

(5) 企业发展优劣势分析

6.2.8 长鑫存储技术有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业业务结构分析

(4) 企业存储芯片业务分析

(5) 企业发展优劣势分析

6.2.9 澜起科技股份有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业业务结构分析

(4) 企业销售网络分布

(5) 企业存储芯片业务分析

(6) 企业发展优劣势分析

第7章：中国存储芯片行业前景趋势预测与投资建议

7.1 存储芯片行业发展前景与趋势分析

7.1.1 行业发展前景预测

(1) 行业发展驱动因素分析

(2) 行业发展前景预测

7.1.2 存储芯片行业发展趋势分析

(1) 行业市场发展趋势分析

(2) 行业技术发展趋势分析

(3) 行业市场竞争趋势分析

7.2 存储芯片行业投资潜力分析

7.2.1 行业投资现状分析

- (1) 全球存储芯片行业投资现状
- (2) 中国存储芯片行业投资现状

7.2.2 行业兼并重组分析

- (1) 行业并购重组案例汇总
- (2) 行业并购重组特征分析
- (3) 行业并购重组趋势分析

7.2.3 行业进入壁垒分析

7.2.4 行业投资风险预警

- (1) 政策风险
- (2) 技术替代风险
- (3) 市场风险
- (4) 其他风险

7.2.5 行业投资价值分析

7.2.6 行业投资机会分析

7.3 存储芯片行业投资策略与建议

7.3.1 行业投资策略分析

7.3.2 行业发展建议

图表目录

图表1：存储芯片相关定义

图表2：存储芯片分类

图表3：存储芯片行业发展模式概况

图表4：存储芯片产业IDM和Fabless模式分析

图表5：2020-2024年中国GDP增长走势图（单位：万亿元，%）

图表6：截至2024年中国存储芯片行业相关政策汇总

图表7：《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》相关内容解读

图表8：《信息产业发展指南》相关内容解读

图表9：2020-2024年中国居民人均可支配收入情况（单位：元，%）

图表10：2020-2024年中国居民人均消费支出情况（单位：元，%）

图表11：2020-2024年中国Ipv6地址数变化情况（单位：块/32，%）

图表12：2020-2024年中国Ipv4地址资源变化情况（单位：万个）

图表13：截至2024年上半年中国分类域名数（单位：个，%）

图表14：2020-2024年中国可穿戴设备出货量（单位：万台）

图表15：2020-2024年中国智能家居出货量（单位：亿台，%）

图表16：2020-2024年中国手机出货量增长情况（单位：亿部，%）

图表17：2020-2024年中国5G手机出货量增长情况（单位：亿部）

图表18：2020-2024年中国智能手机出货量（单位：亿部）

图表19：芯片制程技术发展路线图

图表20：芯片制程及主要应用领域

图表21：存储芯片主要细分行业技术发展概述

图表22：存储芯片产业链全景图

图表23：主要存储芯片产业链布局

图表24：全球半导体产业转移路径图

图表25：2020-2024年全球半导体市场规模及增长情况（单位：亿美元，%）

图表26：2024年全球半导体产品结构分析（单位：%）

图表27：全球存储芯片行业发展概况

图表28：全球存储芯片行业发展历程

图表29：2020-2024年全球存储芯片市场规模（单位：亿美元）

图表30：2024年全球存储芯片产品格局（单位：%）

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202503/479569.html>